

各 位



2013年7月26日

会 社 名 株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 田 明  
(コード番号 6875 東証第一部)

### 台湾現地法人設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、台湾に当社100%出資の子会社（現地法人）を新たに設立し、当社台湾支店の業務を移管することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設立の理由

当社グループは従来より台湾におけるビジネスを展開しており、併せて、本年4月1日の吸収合併により川崎マイクロエレクトロニクス株式会社より承継した台湾支店においても、液晶パネル向けLSIを中心とした事業活動を行っております。今回、アジア地域におけるビジネス拡大のため、新たに現地法人の「信芯股份有限公司」を設立し、セールス・マーケティング、開発、FAE、生産管理の各機能の強化を図り、アジア地域のヘッド・クォーターと位置づけます。

なお、現地法人設立に伴い、台湾支店はその機能を現地法人に移管した後、支店としては閉鎖の予定です。

#### 2. 設立する現地法人の概要

(1) 名称	中文：信芯股份有限公司 英文：MegaChips Taiwan Corporation (予定)
(2) 所在地	中文：105 台北市民生東路三段 129 號 2 樓 英文：RM. B 2F, Worldwide House, No.129, Min Sheng E. Rd., Sec. 3, Taipei 105 Taiwan
(3) 代表者等	董事長：松岡 茂樹（当社取締役副社長 事業管理室長） 董事兼總經理：杉山 仁（当社第4事業部長（兼）台湾支店長）
(4) 事業内容	当社グループのアジア地域におけるビジネス統括拠点として、当社グループ製品の販売、生産管理及びサポート等を行う。
(5) 決算期	毎年3月31日
(6) 資本金（出資比率）	360 百万台湾ドル（当社 100%）

#### 3. 設立の日程

設立に係る取締役会決議日 2013年7月26日  
設立年月日 2013年10月頃（予定）  
営業開始日 2014年1月頃（予定）

#### 4. 今後の見通し

本件による、2014年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

なお、「信芯股份有限公司」は、当社の資本金の額の100分の10相当を超える額の資本金で設立されるため、当社の特定子会社となる予定です。

以 上